

μ 1 ? i

[ "	? i
Kv-ç KI-ç ÈEμ	" 7 %\$ 0" 7 %\$
μ(ÈE ù	N\$ NBY
îTî	• /
Tp	DZDMFT " 7 %\$

ÁÖB«

MĐHK	›ñ NN	†›ñ NN	½ ZE	È^"	îT	0™	ç Èg	KIè †È QDT		ÁÖI
								°'	g	
/PO TIPSUJOH			1\$ CPBSE		-BUDIJOH	4OBQ JO μ	μ			SPPH410100
					.PNFOUB\$Z4USBHUI					SPPH410200
					-BUDIJOH					SPPH420100
					.PNFOUB\$Z					SPPH430100
									SPPH430200	

? i  
Ù

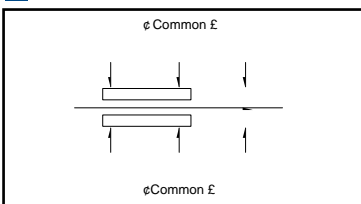

"™ m

6OJU NN

™	†—È^δ½ d jm 1"Z_A

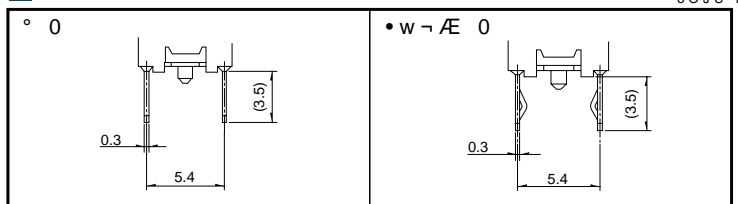
™ m VUμç Èg ÁÖÈ~b



È^m 1"Z\_A



0™

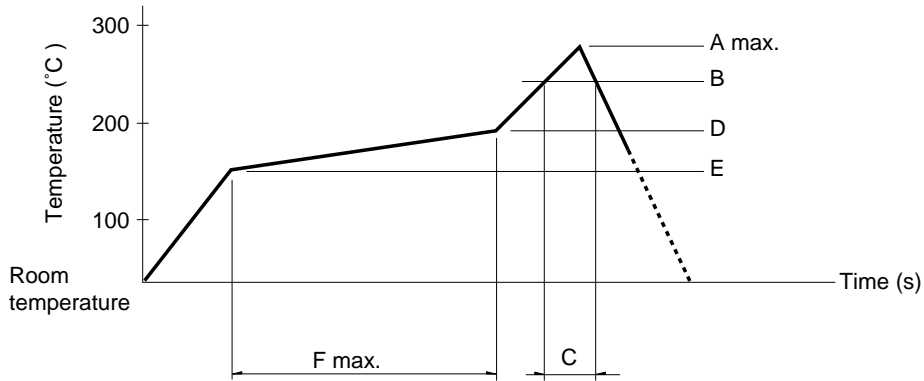
6OJU NN



系列		Vertical			
		SPEH	SPEJ	SPPH4	SPPH1
照片					
外形尺寸 (mm)	W	6	7	6.5	10
	D	6	7	8.5	10
	H	5	5.95	8.5	
行程 (mm)		—	—	2.2	1.5
全行程 (mm)		1.6	1.7	3	2.5
电路数		1	2		
使用温度范围		-40 to +90	-40 to +85	-10 to +60	
车用产品				—	
生命周期					

### 回流方式的参考举例

1. 加热方式 远红外线加热的上下加热方式。
2. 温度测量方式用0.1φ.2的CMA或CC(T)进行测量。在焊接的连接部位置(铜箔面)测量,固定方式使用耐热载体。
3. 温度分布



系列 (回流型)	A ( ) 3 s max	B ( )	C (s)	D ( )	E ( )	F (s)
SPEJ	260	230	40	180	150	120
SPEF						
SPEH						

### 注

1. 上述条件,为印刷电路板的零部件贴装面上的温度,根据电路板的材质,大小,厚度等,回路板温度和开关表面温度会有很大的不同,关于开关表面温度,也请在上述条件内使用。
2. 根据回流槽的种类,条件稍有不同,请事先充分进行确认之后使用。

### 手工焊接方式的参考举例

系列	焊接温度	焊接时间
SPPJ3, SPPJ2, SPUN, SPPH4, SPPH1	350±10	3+1 / 0 s
SPED2, SPED4	350±10	3±0.5 s
SPEJ	350±10	4 s max.
SPEF	350±5	3 s max.
SPEH	350 max.	3 s max.
SPUJ	300±10	3+1 / 0 s

### 浸焊方式的参考举例

适用于 For PC board 端子型

系列	项目		浸焊	
	预热温度	预热时间	焊接温度	焊接浸渍时间
SPPJ3	100 max.	60 s max.	260±5	5±1 s
SPUN	100 max.	60 s max.	260±5	10±1 s
SPUJ, SPPH4	—	—	260±5	5±1 s
SPPJ2, SPPH1, SPED2, SPED4, SPEF	—	—	260±5	10±1 s